

EQUIPMENT

4/16-18, 2025

台北南港展覽館一館4F

電子生產製造設備展

半導體封裝 | 電子生產製造設備 |
化合物半導體 | FOPLP扇出型面板級封裝

展覽介紹 >



3大主題 串聯跨域整合能量

EQUIPMENT

「Touch Taiwan系列展」是台灣上半年規模最大、科技廠商密集度最高的合作交流平台。涵蓋智慧座艙、Micro LED、AI人工智慧、數位轉型、半導體、化合物半導體、動力/儲能電池生產製造設備等主題，集結跨域產業的上中下游供應鏈，共同展示當前的最新技術及發展。Touch Taiwan不僅展示前沿科技，還引領台灣科技產業的未來發展方向，推動產業升級與創新，為參展廠商及與會者提供絕佳的交流與合作機會。

touch
TAIWAN



DISPLAY⁺

智慧顯示展覽會

- 智慧顯示
- 電子紙應用
- Micro & Mini LED
- 智慧座艙
- 工業材料
- 新創學研
- 淨零碳排 & 新能源

SMART⁺

智慧製造展

- AI人工智慧與物聯網
- 數位轉型與系統整合
- 智慧工廠與企業戰情室
- AGV/AMR
- 零信任資安
- 企業數位應用主題館

EQUIPMENT

電子生產製造設備展

- 半導體封裝與組裝設備
- 半導體智動化解決方案
- 化合物半導體設備
- Micro LED生產製造設備
- 電子生產製造設備
- 電子設備關鍵模組/零組件
- 動力/儲能電池生產製造設備
- 先進封裝測試主題館
- FOPLP扇出型面板級封裝

2024 展覽數據

EQUIPMENT

2024年來自**10**國 | **312**家廠商 | **882**攤位 | 吸引**31,890**名海內外專業人士來訪
近**30**場國際論壇, 邀請海內外**159**位專家 | 論壇參與**2,781**位



2024吸引**45**國買主蒞臨交流

海外買主前**15**國

日本、中國、韓國、美國、馬來西亞、
印度、新加坡、越南、柬埔寨、印尼、
法國、德國、加拿大、泰國、菲律賓等



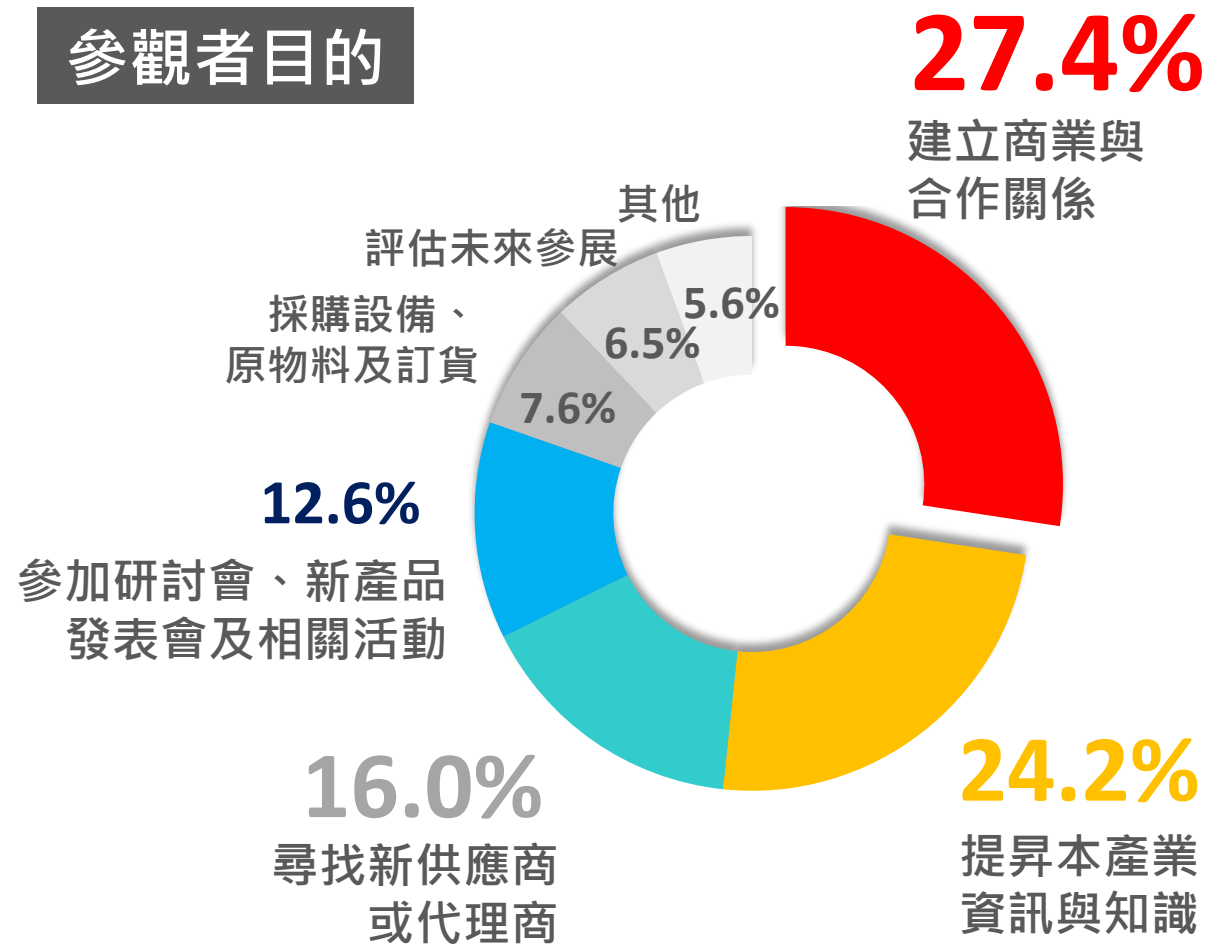
Lead to infinity
— 引領無限未來 —



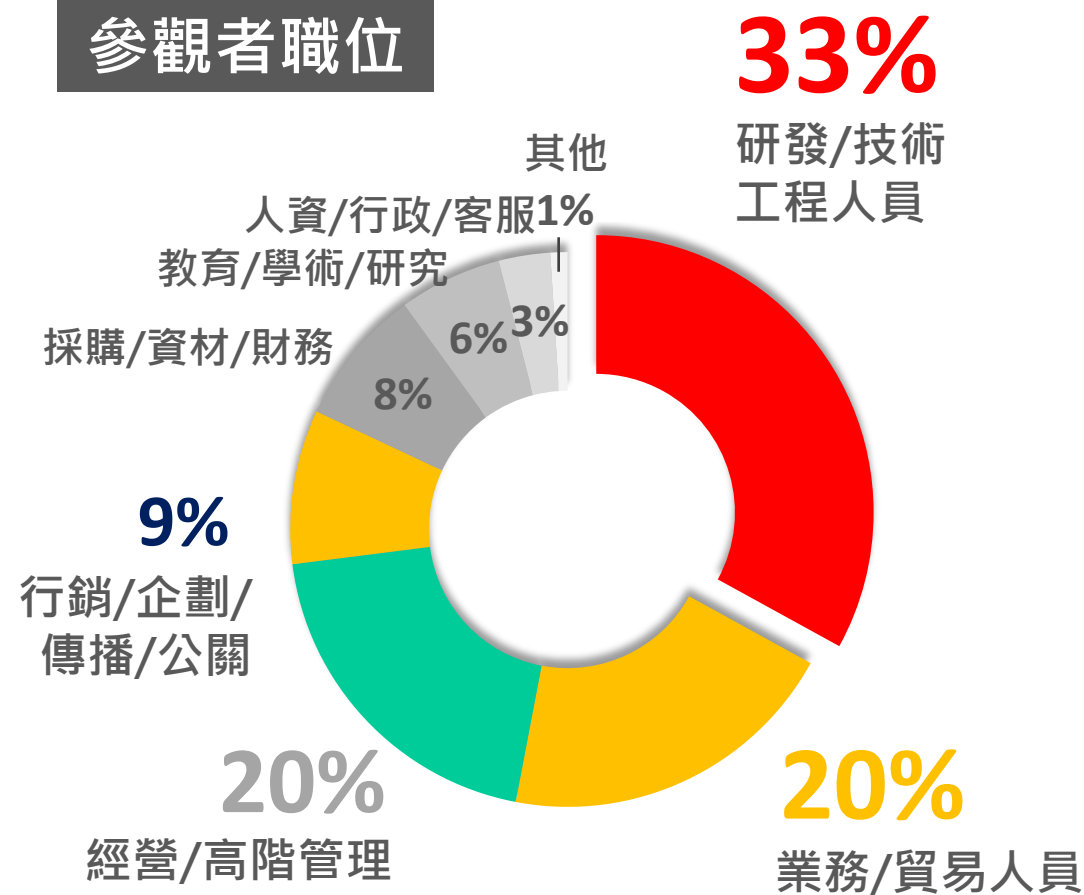
參觀者目的/職位分析

EQUIPMENT

參觀者目的



參觀者職位

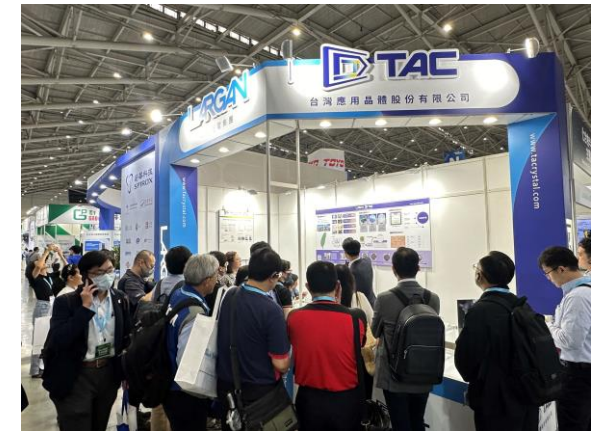
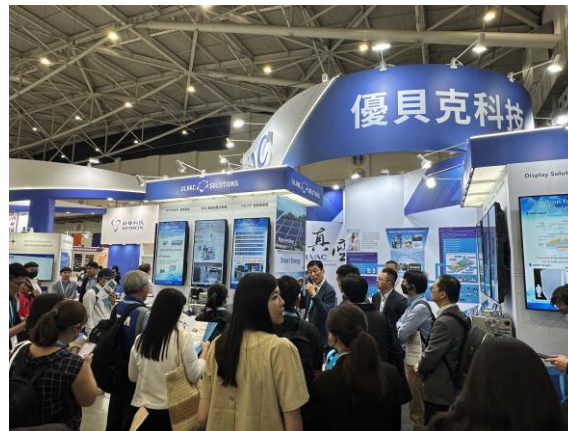
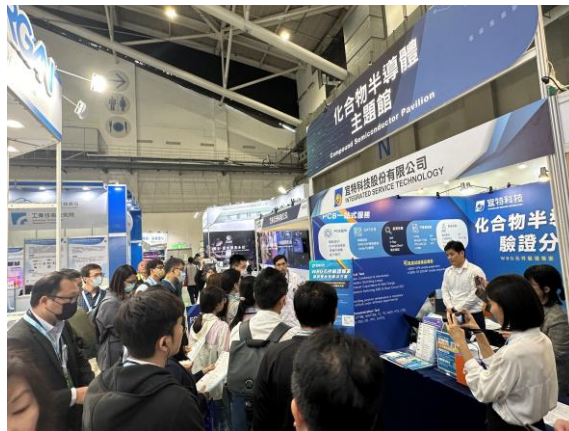
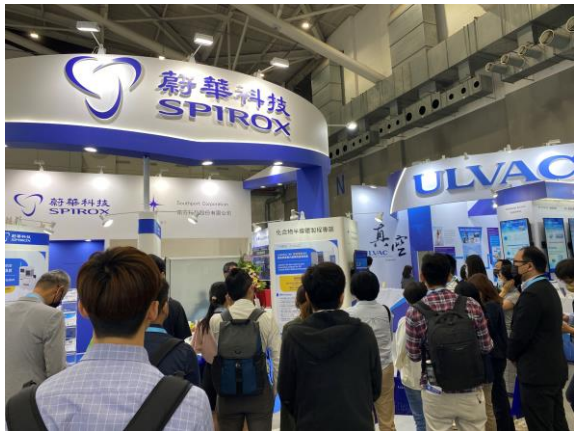


精選主題館 展期精采呈現

化合物半導體主題館

化合物半導體專區集結了許多半導體產業重要的廠商蔚華、優貝克、北聯、準力、台應晶、宜特、亞正、閎康、創技、岱美展出碳化矽材料、化合物半導體解決方案以及用於SiC的加工製程等技術，提供觀展者最完整的技術科技，建構一個化合物半導體的產業生態圈！

EQUIPMENT



2025展示項目

EQUIPMENT



半導體封裝組裝設備



半導體智動解決方案



化合物半導體設備



Micro LED生產製造設備



動力/儲能電池生產製造設備



電子設備關鍵模組/零組件



電子生產製造設備



封裝測試主題專區 **New**

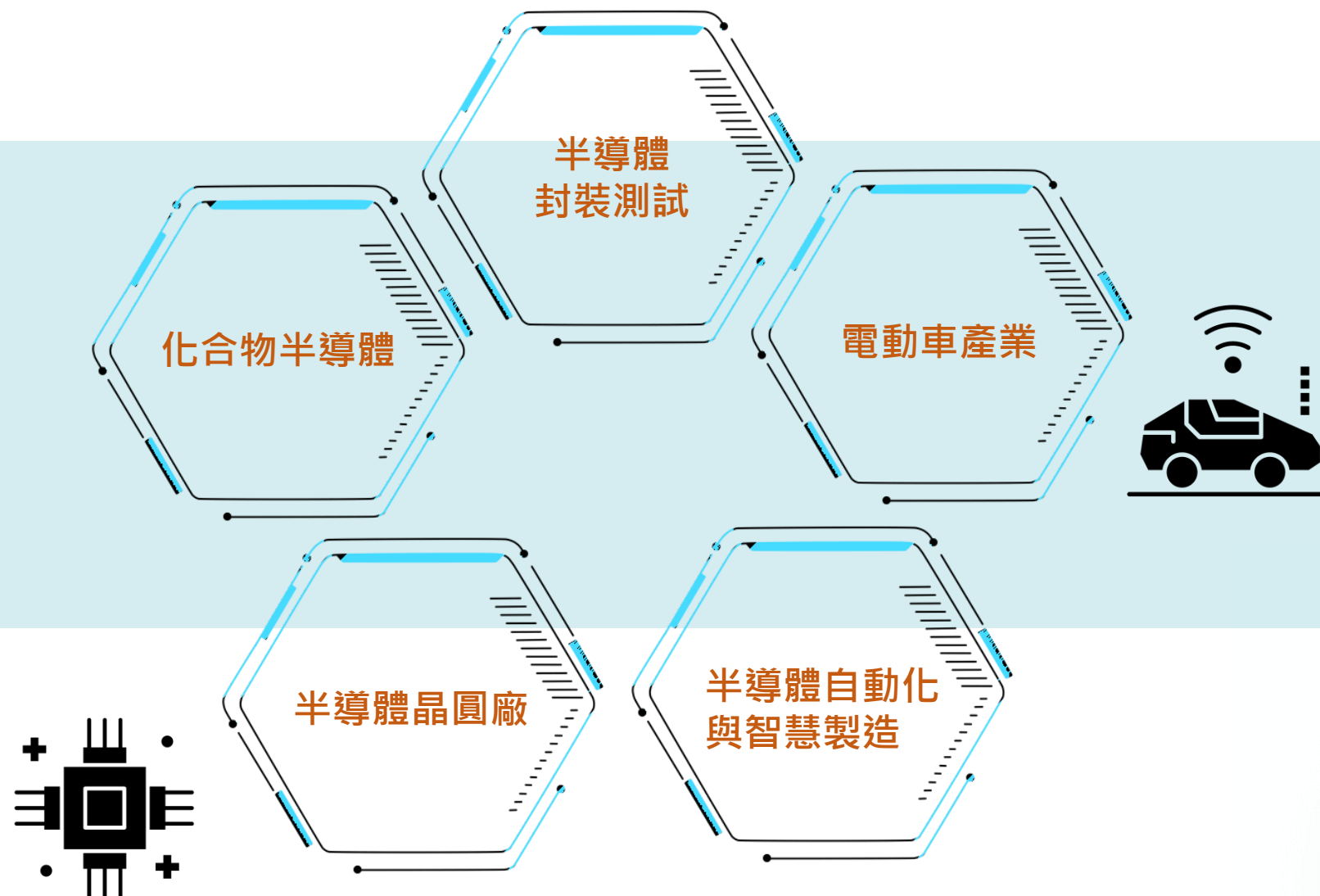


FOPLP扇出型面板級封裝 **New**



目標族群

EQUIPMENT



合作媒體

EQUIPMENT

展期三天 超過300位海內外記者蒞臨

 東森電視

 三立新聞網
SETN.COM

 年代電視

 中天電視

 壹電視
NEXT TV

 anue
鉅亨

 民視

 公共電視

 非凡新聞

 人間衛視
BLTV

 中時新聞網

 NTD

工商時報

 DIGITIMES

經濟日報

自由時報

 今日新聞
NOW NEWS

臺灣醒報

聯合報

ASPENCORE

 CT
中華時報

 TAIWAN

CIO Taiwan

 CTIMES

 天下雜誌
Commonwealth Magazine

 今周刊

 財訊
WEALTH MAGAZINE

 Micro-Electronics
新電子

 etm Eastern
Trade Media Pte Ltd

 商周

 經貿透視
雙周刊

遠見

 Business Next
數位時代

 鏡報
MIRROR MEDIA

 CNA

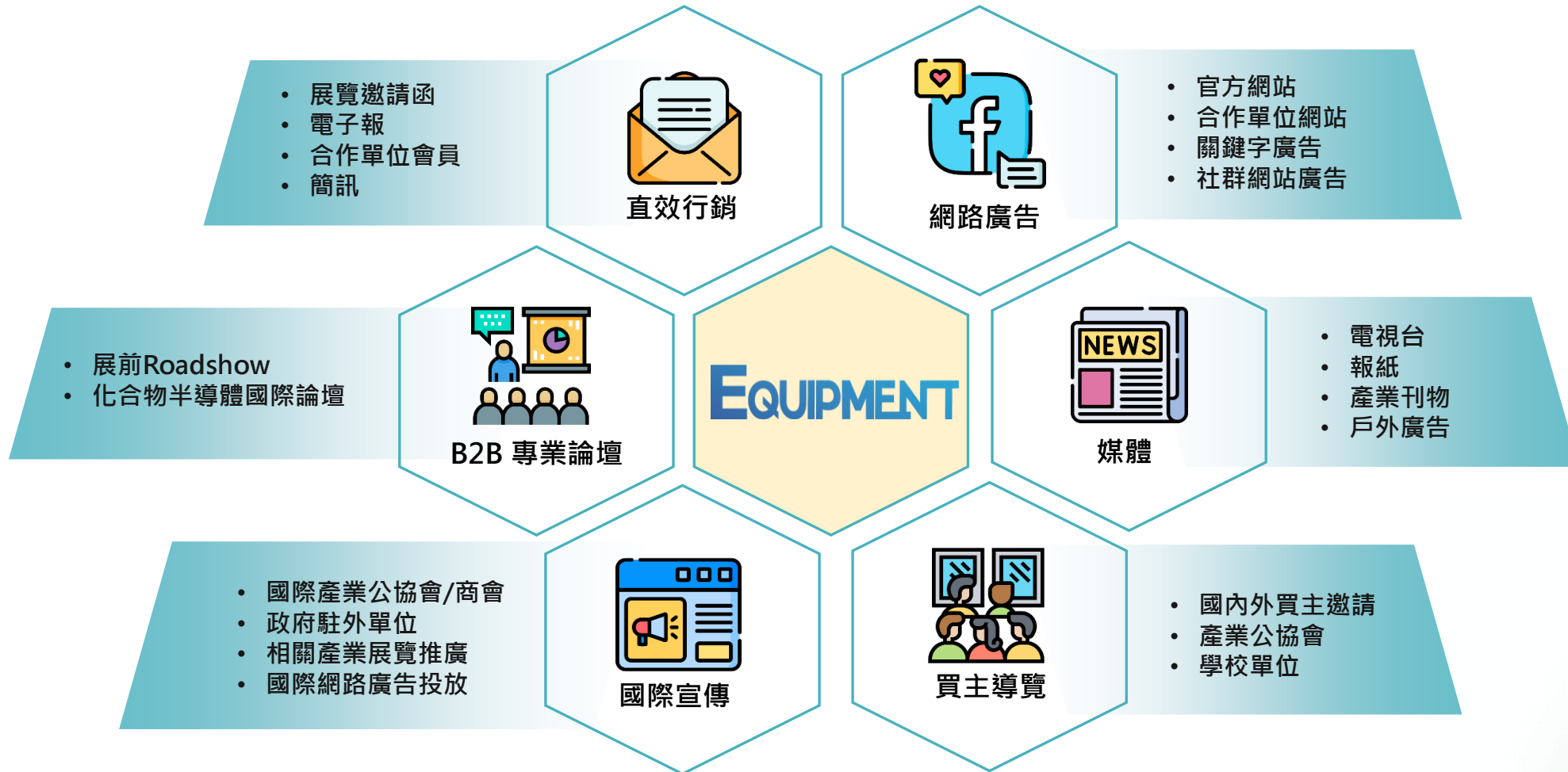
 MoneyDJ
理財網

 NIKKEI
日本經濟新聞

*僅列出部分媒體單位

精準行銷服務

EQUIPMENT



展示攤位價格

EQUIPMENT

攤位規格	原價	早鳥價至8/31	會員價
淨空地攤位	53,000	50,000	47,000
標準裝潢攤位	57,500	54,500	51,500
主題館攤位	63,000	60,000	57,000

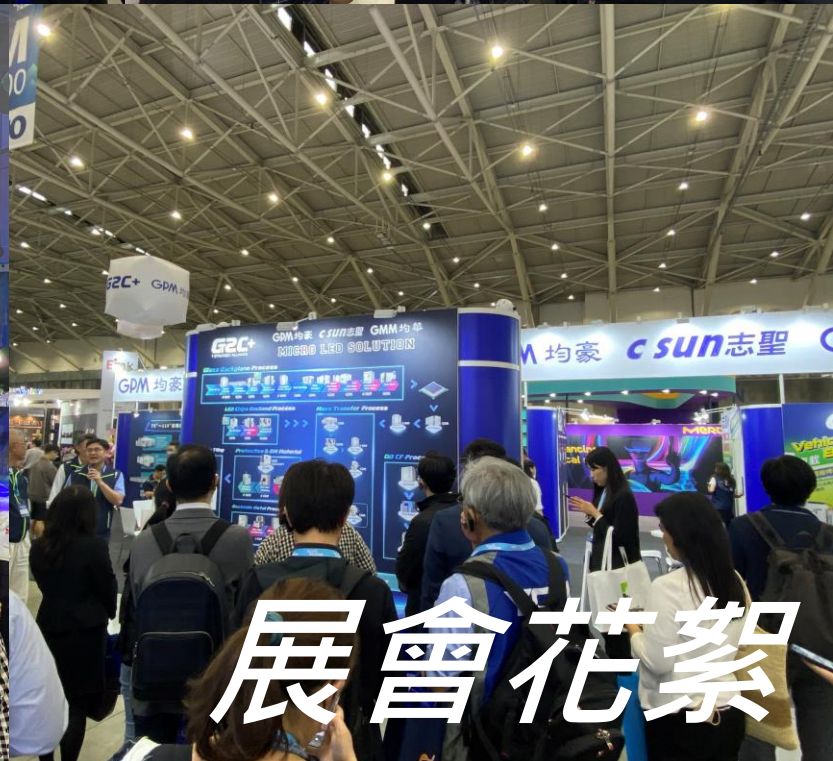
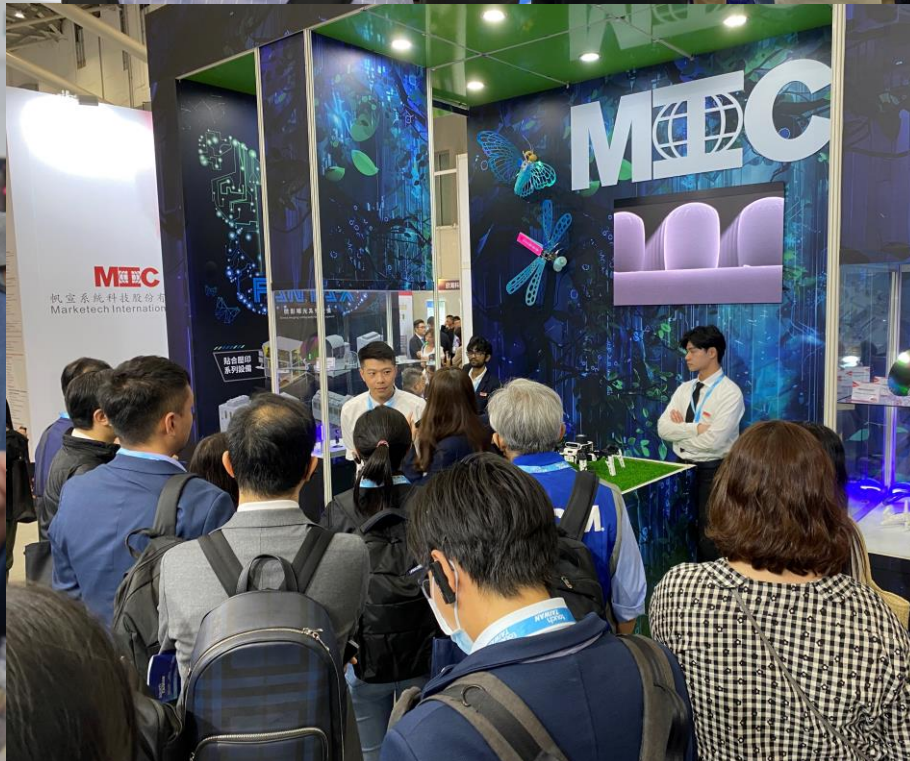
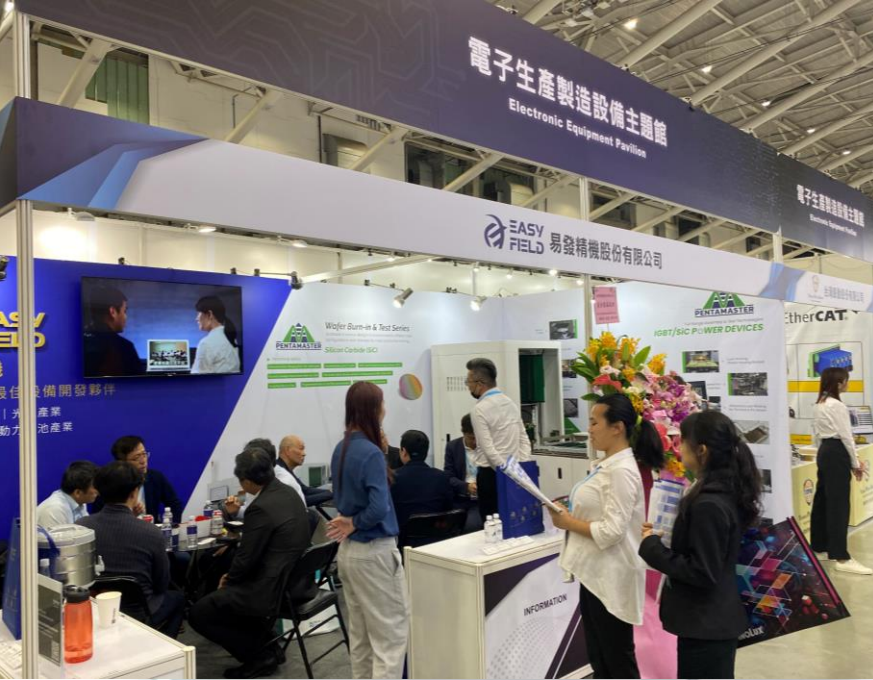
- 1.凡加入TDUA、TEEIA、TPSA、TDMDA、SID會員可享會員優惠價。
- 2.標準裝潢配備(大會代辦基本裝潢)每一個攤位費用為NT\$ 4,500(未稅)。
- 3.標準裝潢攤位: 配備包括三面隔間牆、三盞投射燈、110V插座一個、地毯一張(9平方米)、公司招牌一組及接待桌椅各一張。
- 4.主題館攤位:基本隔間(3M*3M)、地毯(淺灰)、接待桌輸出(96.7*66)、接待桌(100*50*H75)、玻璃圓桌(DIA75)*1、折椅(黑色)*4、13WLED、長臂燈_白光*6、110V/5A插座*1。
- 5.動力用電、24小時供電、配置水管用水、空壓機及堆高機作業,須依收費標準繳費。

標準裝潢示意

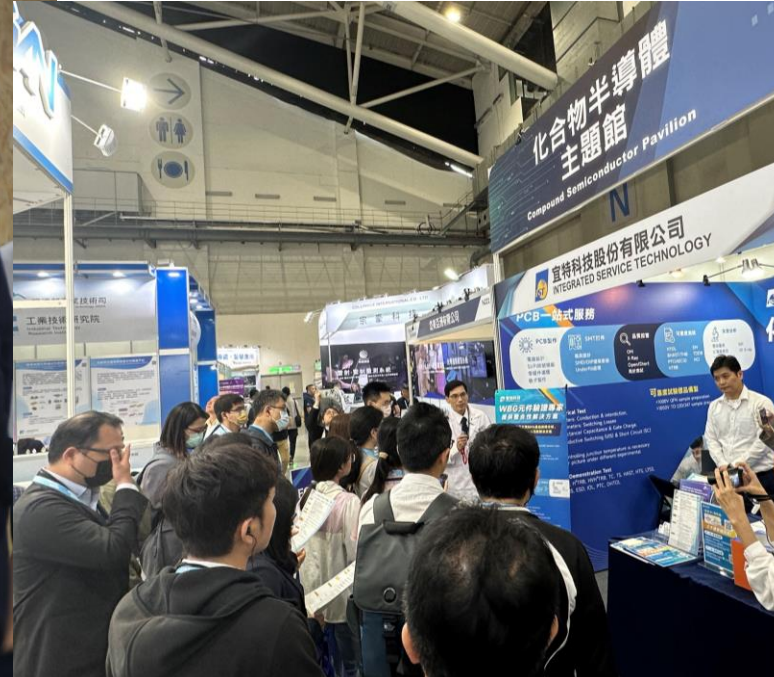
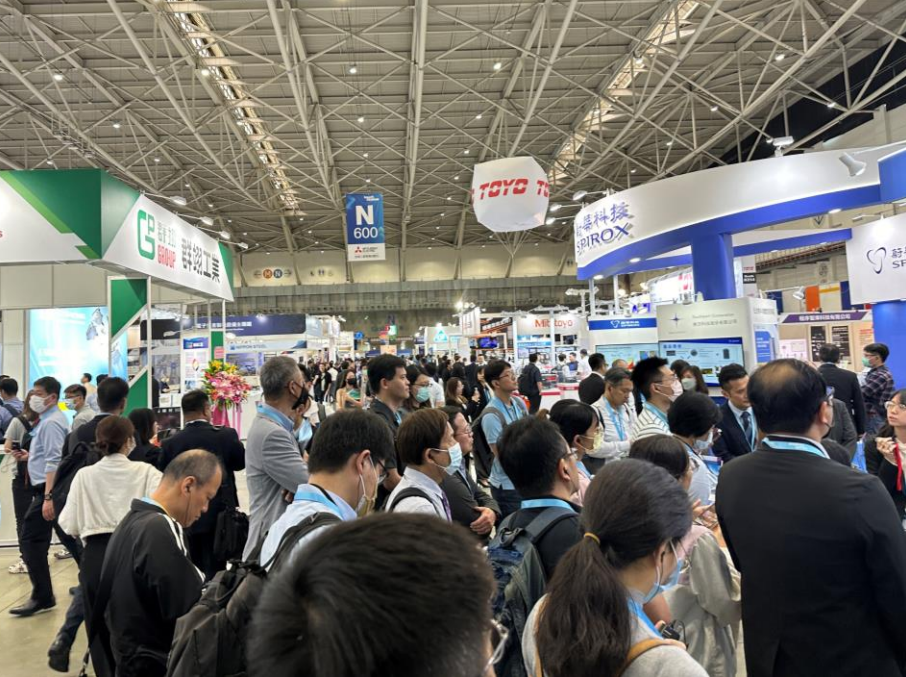


主題裝潢示意





展會花絮



展會花絮

化合物半導體國際論壇 贊助方案

項目內容		銀級	金級
演講 (主辦單位保留安排議程與時間“30分鐘”權利) * 海外講師可使用線上直播或錄影檔案		無	○
TEEIA官網首頁	專屬banner輪播 *60天(含假日)	○	○
網路曝光	公司介紹文 *Facebook：1圖+文字300內	○	○
	會後報導(含外稿記者)	無	○
論壇講義封面/內頁/(公司 Logo/介紹)		○	○
會場佈置看板Logo		○	○
特製看板(100x200cm)		無	○
企業瓶裝水(24瓶/10箱)		無	○
論壇VIP公關票		2張	5張
化合物半導體供應鏈之夜 門票		1張	2張

■主辦單位保留變更內容之權利

■金級or銀級之贊助廠商，將於化合物半導體供應鏈之夜頒發獎牌一座

■詳細贊助方案請洽主辦單位：02-2729-3933#12 doris@teeia.org.tw

化合物半導體晚宴 贊助方案

贊助項目	主辦單位提供配套	贊助費用	贊助商數量
化合物半導體 供應鏈之夜	■ TEEIA官網首頁：專屬banner輪播 (60天/含假日) ■ 品牌曝光：會議開始前及休息時間播放3分鐘宣傳片(影片檔由贊助廠商自行提供) ■ 大會主背板Logo曝光 ■ 贊助單位推派代表上台致詞(5分鐘內) ■ 論壇VIP公關票 名額5人 ■ 化合物半導體供應鏈之夜 門票2張 ■ 晚宴規模：80人	請洽主辦單位	單一企業冠名贊助



■主辦單位保留變更內容之權利

■金級or銀級之贊助廠商，將於化合物半導體供應鏈之夜頒發獎牌一座

■詳細贊助方案請洽主辦單位：02-2729-3933#12 doris@teeia.org.tw

為什麼要贊助論壇

1. 品牌曝光：使品牌在行業內獲得額外曝光，提高知名度，吸引更多目標客戶和合作夥伴的注意。
2. 業務聯繫：參與論壇將有機會與產業界的專業人士、企業高層和決策者建立重要聯繫，促進業務發展和合作機會。
3. 專業知識分享：將為公司同仁提供論壇主題之最新發展、趨勢和技術的機會，保持競爭優勢並擴大專業知識。
4. 專屬演講機會：將有機會在論壇現場進行品牌展示，吸引參會者的關注。
5. 活動宣傳：贊助商的名稱將被曝光到所有相關活動和宣宣材料中，包括官方網站、印刷品和社群平台，進一步強化品牌影響力。
6. 社會貢獻：做為贊助商，您將支持行業內的知識分享和交流，並促進行業的可持續發展。

2024 化合物半導體國際論壇

International Compound Semiconductors Conference 2024



陳宗鼎 Richard Chen
Vice President

09:40 - 10:10
Increased PFC power efficiency by GaN, coming EMI issues and solutions.



尤進德 Louis You
Chief Operating Officer

10:10 - 10:40
Silicon Carbide Wafer Burn In.



李坤彥 Kung-Yen Lee
Founder

10:40 - 11:10
The SiC power devices for the fast charger.



林育廷 Tim lin
Sales Manager

11:10 - 11:40
COHERENT 化合物半導體的沿革與願景



英飛凌



魏致祺 Lucas Wei
Senior Director

11:40 - 12:10
GaN or SiC ? GaN & SiC ?
WBG is the future.

2024 講師陣容

Speaker Lineup



Taguhi YEGHOYAN
PhD.

13:45 - 14:15
Semiconductor equipment market and technologies for the production of SiC devices.



倉又 朗人 Akito Kuramata
CEO

14:15 - 14:45
Ga2O3 Single Crystal Wafers for Power Device Applications.



Ian Wright
VP, Sales and Business Development, Asia, Oxford Instruments Plasma Technology

14:45 - 15:15
Plasma polish solution to prepare Epi-ready SiC substrates for Power Applications.



趙維江 Zhao Weijiang
Executive Engineer

15:15 - 15:45
About three times higher productivity than conventional products Ion-implanters for SiC power devices 「IMPHEAT-II」.



林甲威 Rain
Vice President of Marketing

16:00 - 16:30
Turnkey Solution for SiC Test and Reliability.



David Mawby
Co-Founder & Director

16:30 - 17:00
TCAD tools for wide bandgap Power device development.

與會者職位分析

Attendee Position Analysis

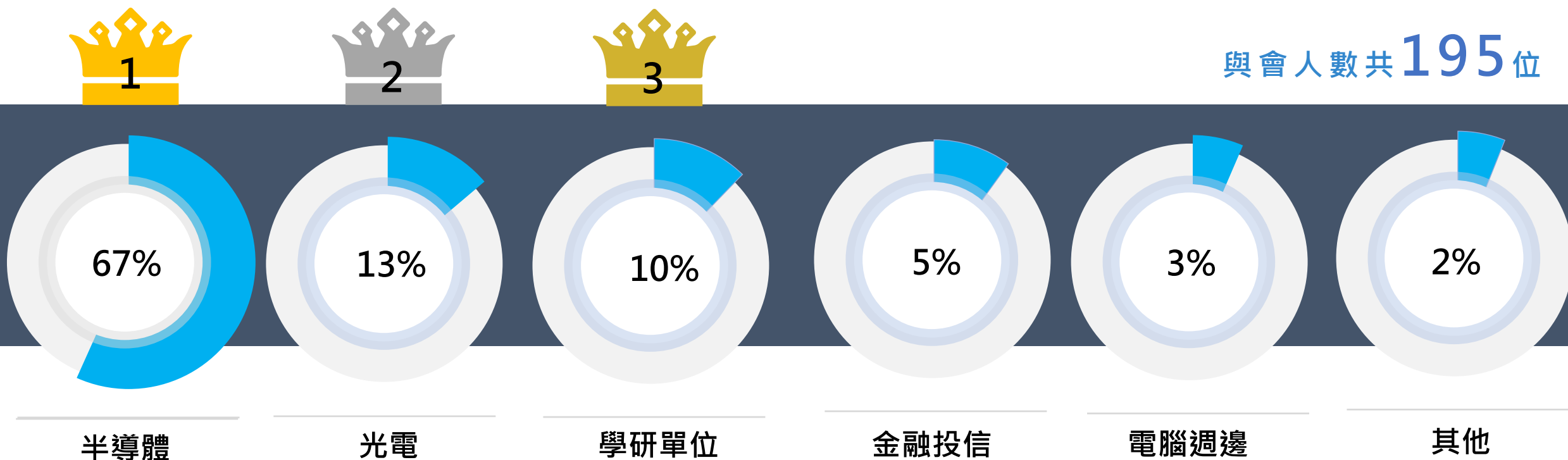
與會人數共 195 位



與會者產業分析

Attendee Industry Analysis

與會人數共 195 位



感謝所有講師及贊助廠商的支持，我們2025年見！

2022



2023



2024



EQUIPMENT 4/16-18, 2025
台北南港展覽館一館4F

電子生產製造設備展

半導體封裝 | 電子生產製造設備 |
化合物半導體 | FOPLP扇出型面板級封裝

聯絡
窗口

台灣電子製造設備工業同業公會(TEEIA)

林小姐 (02) 2729-3933#12
doris@teeia.org.tw

展昭國際企業股份有限公司

李先生 / 林小姐 (02)2659-6000 #135 #192
touch@chanchao.com.tw

